

高密度高多層プリント配線板

最先端のICTインフラ製品をはじめ、高機能商品に長期適用される
高信頼、高多層プリント配線板をご提供

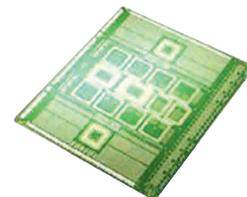
高多層プリント基板

- ハイアスペクト対応技術により多層配線板の高密度化が可能
- 要求伝送損失を実現する材料・層構成・プロセスをご提案
- 鉛フリー実装や高放熱部品に対応した高耐熱基板をご提案

仕様

(mm)

板厚	1.6以下	4.0以下	5.0以下	6.5以下	8.0以下
Via径	φ 0.15	φ 0.20	φ 0.25	φ 0.30	φ 0.35
Land径	φ 0.35	φ 0.40	φ 0.45	φ 0.50	φ 0.55
Line/Space	0.05 / 0.05mm ~ 0.09 / 0.09mm(導体厚による)				



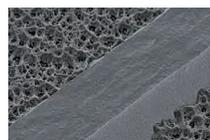
高多層基板

断面

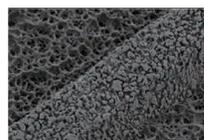
層構成 : 50層 (2層 IVH付)
板厚 : 7.2mm
Via径 : φ 0.35mm (IVH φ 0.12mm)

高速伝送対応～導体表面平坦化技術

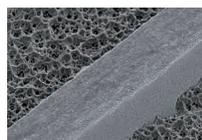
- 豊富なラインナップから最適な高周波対応材料をご提案
- 50Gbpsを超える高速伝送にも量産対応
- 化学密着技術で表皮効果による損失を極限まで低減



処理前の導体表面

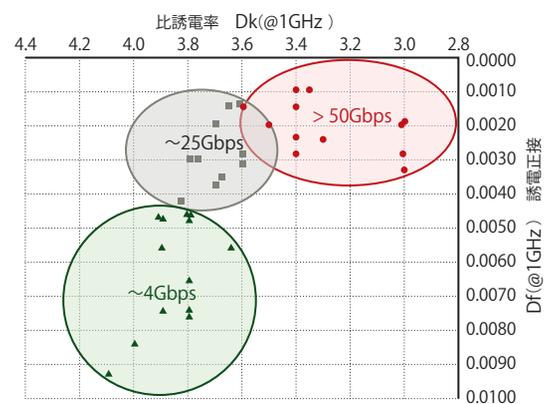


従来の粗化処理後



化学密着適用後

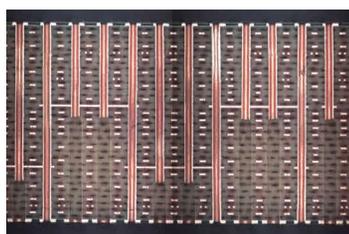
導体パターン表面平坦化プロセス改善



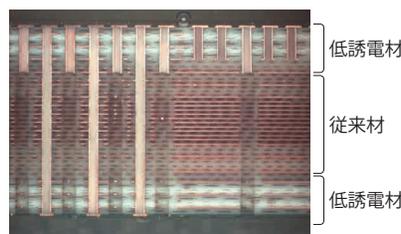
低誘電材料と導体表面平坦化で50Gbpsを実現

高速伝送対応～不要スタブレス構造の提案

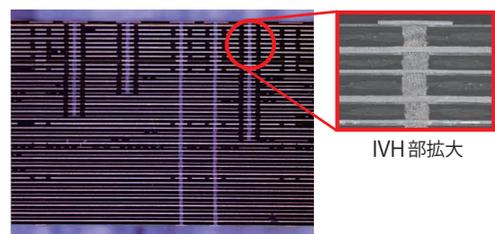
- 不要なViaスタブを可能な限り排除するための構造、工法をご提案
- 異種材料の多層積層、貼り合わせ積層技術によりローコスト化が可能
- 設計段階より電気特性を考慮した層構成/デザインルールをご提案



バックドリル技術



異種材の貼り合わせ積層技術



全層 IVH 構造 F-ALCS 技術

IVH 部拡大

